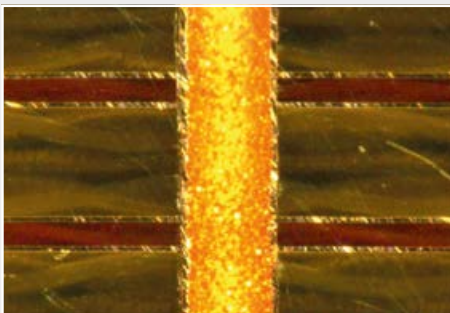


卓上型スルーホール用電解めっき槽 LPKF Contac S4

- マイクロビアのクリーニング機能付
- すずめっきオプション
- 均一な銅層形成
- 簡単操作



信頼性のあるスルーホール形成



LPKF Contac S4は両面基板だけでなく多層基板においても信頼性、均一なスルーホールを作成できます。

研究室でのスルーホール作成 - LPKF Contac S4 による電解めっき

信頼性あるスルーホール形成はPCB試作プロセスにとって非常に重要です。

新型のContac S4はコンパクトで安全な筐体で電解めっきを行うことができるめっき槽です。

電解スルーホールめっき

2層や多層基板の導通を取ることはPCB試作に不可欠な作業です。コンパクトなLPKF Contac S4には6つの槽が搭載されており確実にスルーホールめっきを作成できます。基板を各槽に順番に入れていくだけで、多層基板においても、すべてのビアの表面に信頼性の高い銅層が生成されます。

Contac S4は最大アスペクト比 1:10 (孔径: PCB厚み) の8層基板まで加工できます。

LPKF Contac S4は、さらに表面保護とはんだ性がよくなるすずめっき用の槽が追加されています。

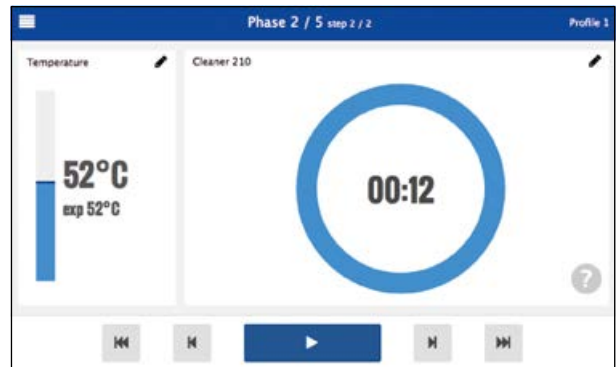
改良された銅層ビルドアップ

LPKF Contac S4には銅層を確実に形成するための技術が詰まっています。最適化されたアノード板とPRめっきにより均一な銅膜の形成が行われます。カーボンの活性化を使用したブラックホール技術、エア攪拌機能、ビア洗浄工程による層間剥離のない銅層の接続、などの技術が搭載されています。結果として穴内部、表面に均一なめっきが施されます。

簡単操作

タッチパネルによりウィザードやパラメータ管理ができ、電解めっきプロセスに不慣れなユーザーでも安全に操作できるようガイドしてくれます。慣れているユーザーはいつでも設定をカスタマイズすることができます。

このめっきプロセスには化学知識やめっき液の分析は必要ありません。システムは自動的に必要なメンテナンス工程を知らせてくれます。また新しい筐体は耐薬品性、耐変色をかねそなえています。Contac S4は機能的で、デザインの優れた実用性のあるめっき槽です。



全ての工程をガイドする新型ユーザーインターフェイス

LPKF Contac S4

最大基板サイズ (X x Y)	230 mm x 330 mm (9" x 13")
最大加工サイズ (X x Y)	200 mm x 300 mm (7.8" x 11.8")
PRめっき	対応
公差	± 2 µm (めっき後)
最小穴径	≥ 0.2 mm (8 mil)
ビアクリーナー槽	搭載
化学すずめっき	搭載
加工時間	約 90 - 120 分
電源	115/230 V, 50 - 60 Hz, 0.6 kW
装置寸法 (W x H x D)	856 mm x 446 mm x 542 mm (33.7" x 17.5" x 21.3")
重量	~ 80 kg (本体), ~ 115 kg (薬品込)

LPKF Laser & Electronics 株式会社 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1-1 ららぽーと三井ビルディング8F

Phone +81 (0) 47 432 5100 info.japan@lpkf.com <http://jp.lpkf.com>

www.lpkf.com/contact-s4



© LPKF Laser & Electronics株式会社は、予告なく使用および製品情報を変更する場合があります。